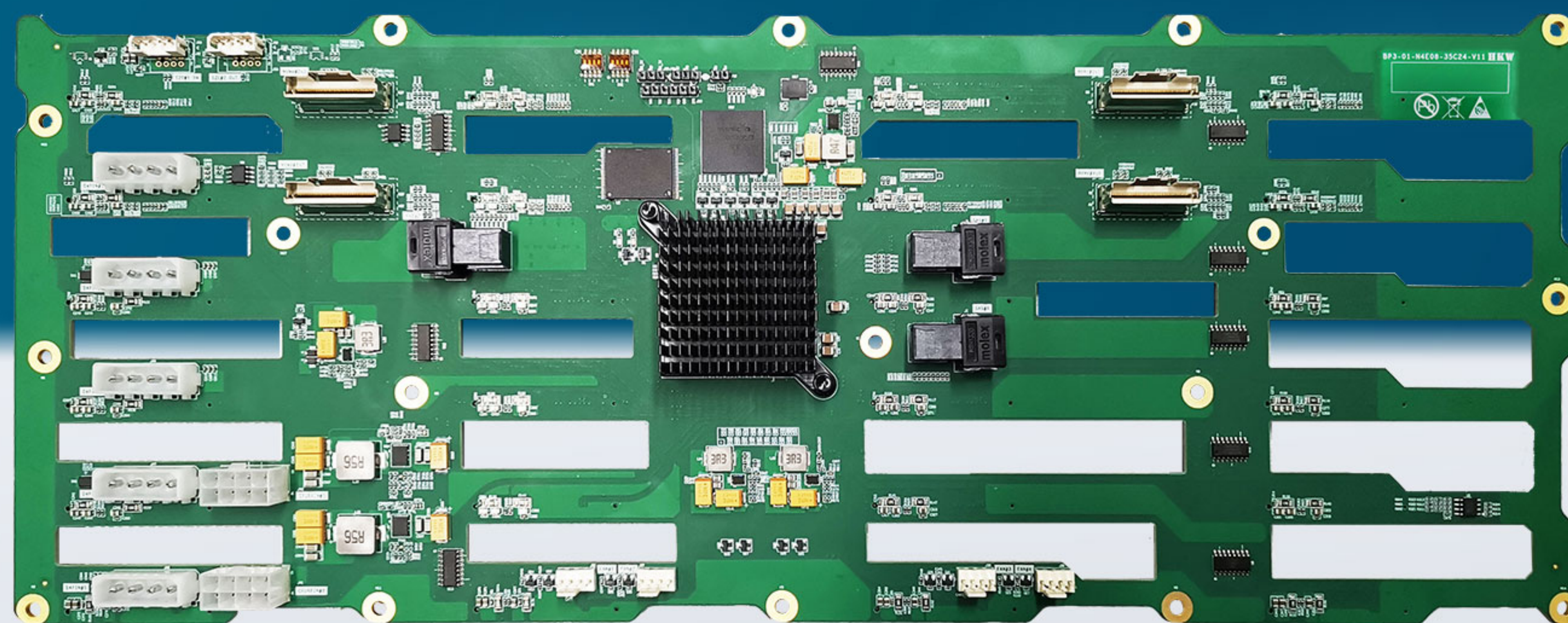


NVMe

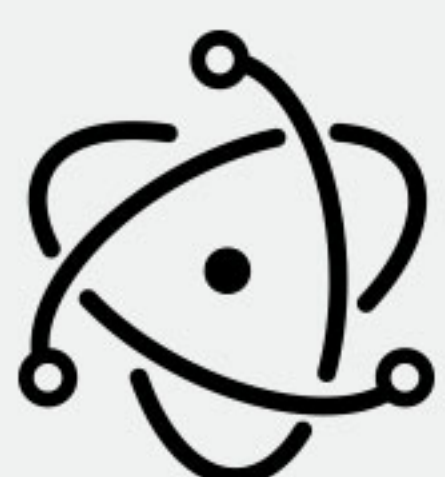
混合扩展硬盘背板



产品概述

- 4U24盘位 NVMe混合扩展硬盘背板；
- 支持3.5"/2.5" NVMe/SAS/SATA硬盘，标准SFF规范设计开发；
- 支持SGPIO和I²C管理信号接口，可以满足NVMe/SAS/SATA硬盘LED管理和BMC通讯；
- 支持Intel&AMD全平台，风扇自动调速，固件在线升级，适配主流硬盘、线缆、板卡，布局和散热超行业标准优化；
- 适合主流混闪和通用服务器，分布式系统，大数据，云服务等场景；
- 覆盖互联网、电信、金融、政府、交通、院校等行业。

产品特性



全平台兼容



风扇自动调速



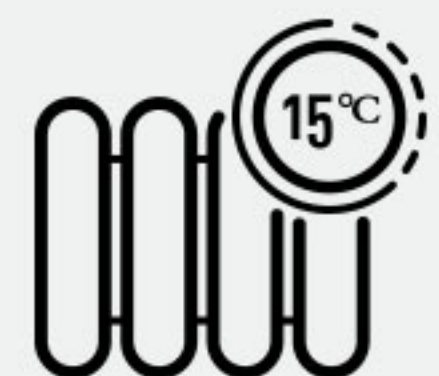
固件在线升级



BMC兼容适配



主流兼容列表



系统散热优化



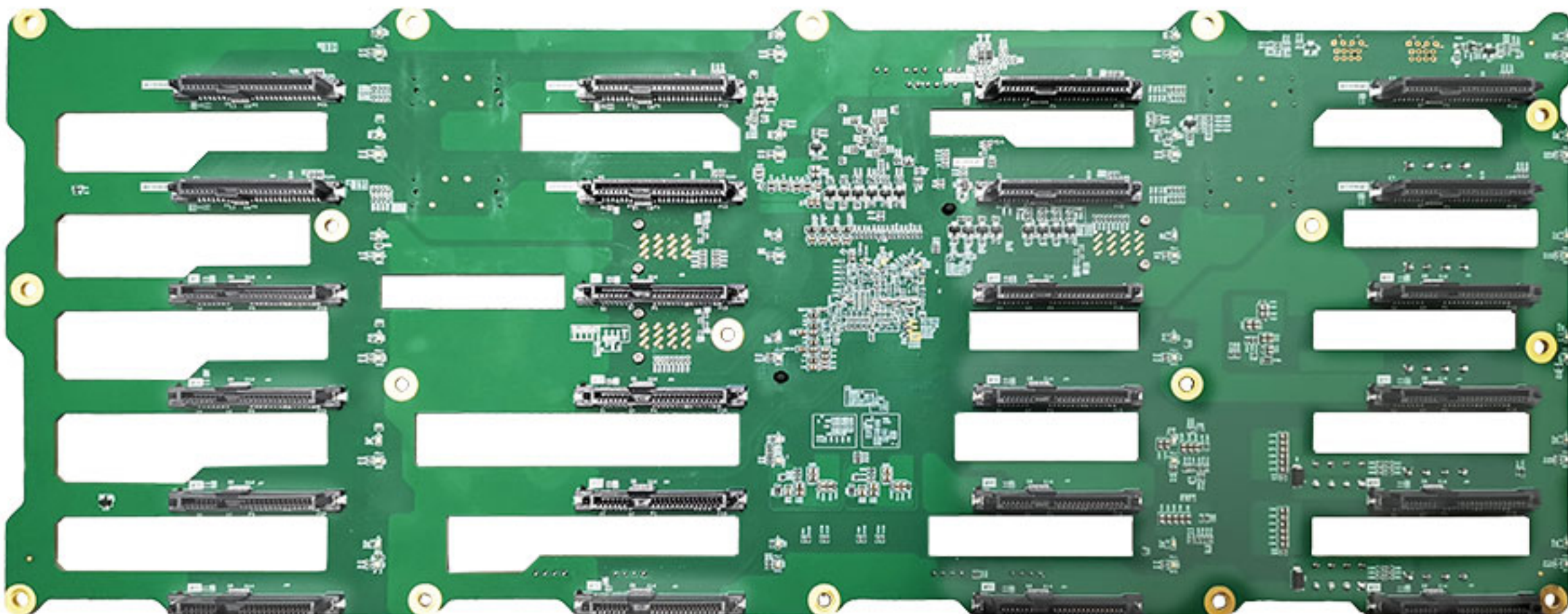
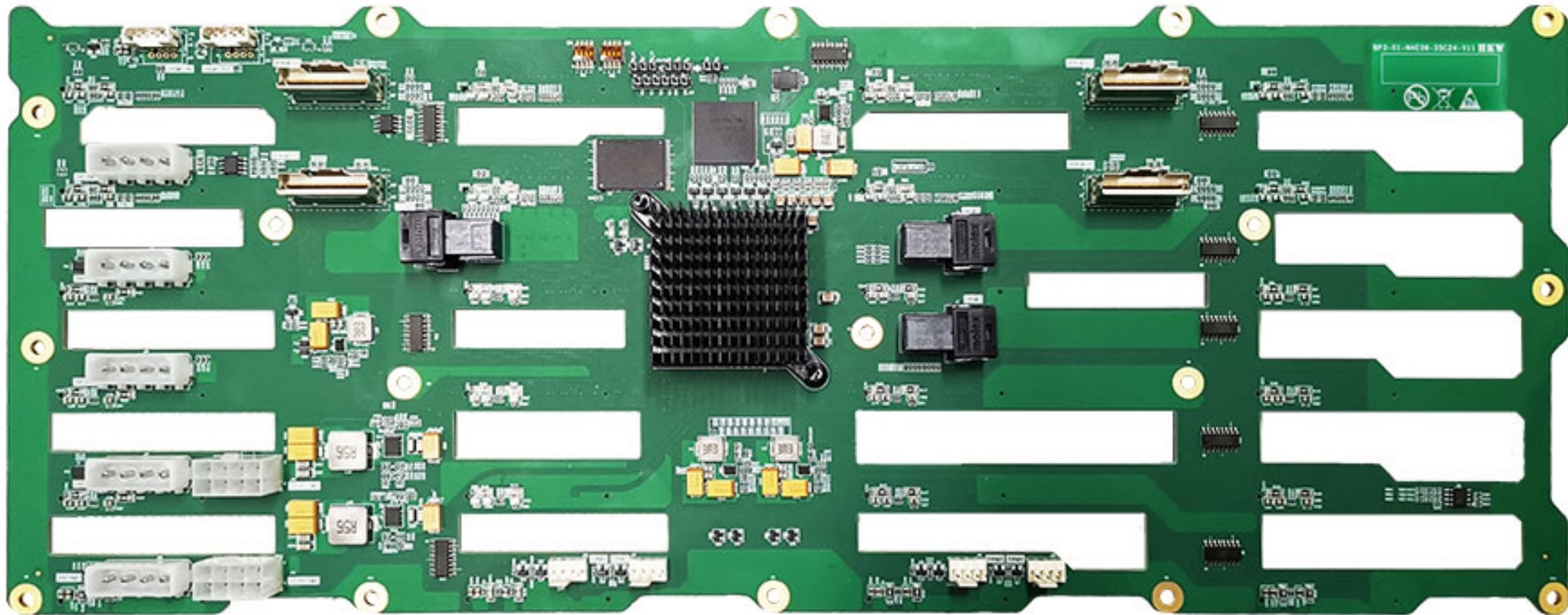
系统布局优化



BOM优化管理

技术规格

组件	描述
类型	NVMe硬盘背板
系列	NVMe混合扩展硬盘背板
规格	3.5"/2.5" 4U24
盘位	24盘位
速率	PCIe 4.0 16GT/s & SAS 3.0 12Gb/s
硬盘接口	SFF-8639*8 & SFF-8482*16
上行接口（PCIe）	Slimeline x8 SFF-8654 x8*4（遵循SFF-9402 R1.1规范）
上行接口（SAS）	MiniSAS HD SFF-8643 x4*3（遵循SFF-9402 R1.1规范）
电源接口	CPU 8PIN 12V*2 / D4PIN 12V&5V*5
风扇接口	FAN4PIN风扇*4（支持监控）
管理信号	- 支持SGPIO（SAS/SATA硬盘LED） - 支持I²C*2（NVMe U.2硬盘LED&BMC通讯）
硬盘LED	- 绿灯 Activity（SFF-8489规范） - 蓝灯 Locate 红灯 Fail（双色灯）（SFF-8489规范）
扩展芯片	Broadcom 35x系列
通风孔面积	24.52%
重量	490.2g
产品特性	- 全平台兼容 - 主流兼容列表 - 风扇自动调速 - 系统散热优化 - 固件在线升级 - 系统布局优化 - BMC兼容适配 - BOM优化管理
产品编号	20220240002



华科微（北京）科技有限公司

地址：北京市海淀区唐家岭路百旺弘祥科技文化创意园3号楼2层3228

网址：www.huakewei.com.cn

固定电话：010-82825150 手机：18500365505